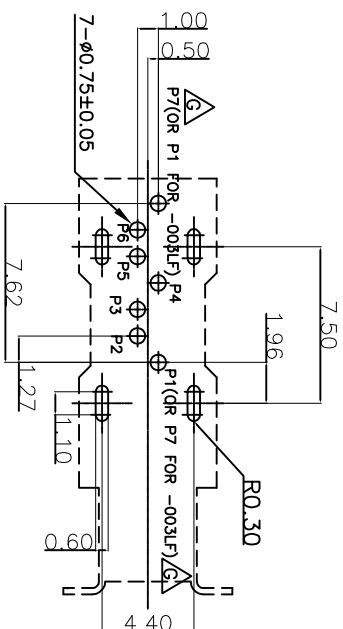
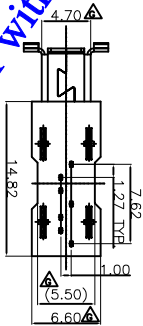
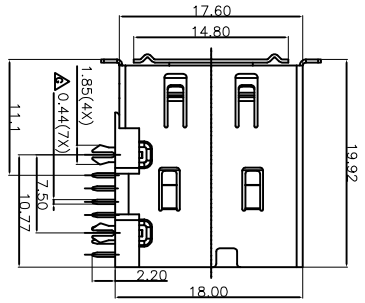
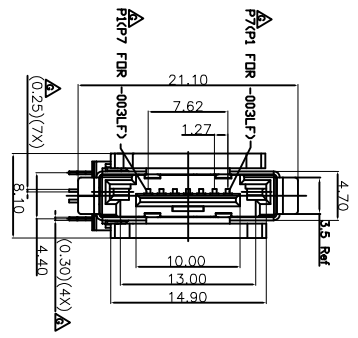
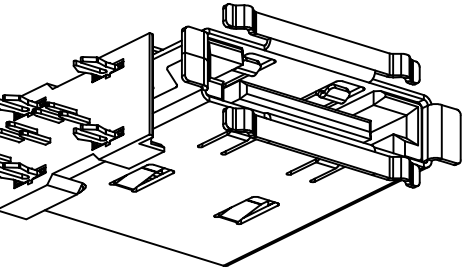


PRODUCT NO.
10074141-001LF
10074141-003LF



PDFfill PDF Editor with Free Writer and Tools

RECOMMEND P.C.B.O.A.R.D. LAYOUT
PCB TOLERANCE:±0.05

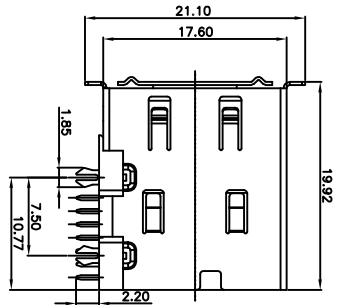
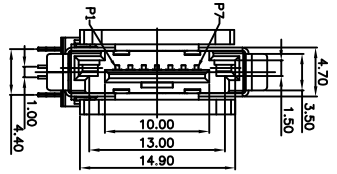
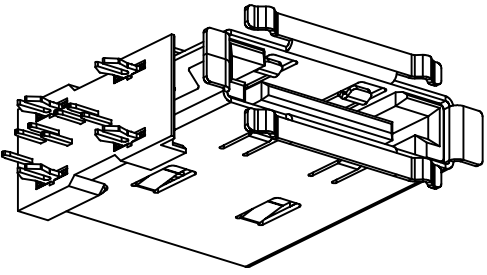


PIN DEFINITION

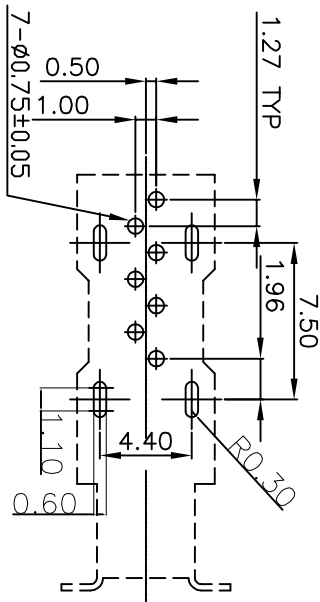
ESATA	NAME	TYPE
P1	GND	GND
P2	A+	A+
P3	A-	A-
P4	GND	GND
P5	B-	B-
P6	B+	B+
P7	GND	GND

mat'l. code	14	surface	ISO 1302	tolerance	ISO 406	ISO 100	projection	product family	533
ltr	ecn no	dr	date	ISO 1302	tolerance unless otherwise specified	ISO 100	projection	product family	533
A	107-1074S	LIN	2007-05-23	angles	.XX±0.25	MM		E-SATA_UP_RIGHT	
B	108-1082S	LIN	2008-04-28	linear	.XX±0.25	MM		DIP_TYPE	
C	110-0184S	LIN	2010-12-14	σ±Z	.XXX±0.100	scale 2:1			
D	I-00544QS	LIN	2011-08-31	STERLING	LIN	2007-05-21			
E	EX-S-00781	HKL	2011-10-17	ENG	HKLIM	2016-03-03			
F	EX-S-01181	HKL	2012-06-08	CH	HKLIM	2016-03-03			
G	EX-S-23401	HKL	2016-03-03	DPD	KPTAY	2016-03-03			
Sheet	Revision	G	G	G	107109	111113	115117	119121	123125
Index	Sheet	1	2	3	106108	110112	114116	118120	122124
					126128	130132	134136	138139	

- NOTES:
1. MATERIAL: HOUSING: THERMAL PLASTIC HIGH TEMP WITH 30% G/F U94 V-0
 2. FINISH: 50U" MIN. NICKEL UNDERPLATING OVER ALL SHELL/BOARD LOOK: 50U" MIN. NICKEL PLATING OVER ALL IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6MM PCB
 3. THE HOUSING WILL WITHSTAND TO 280C FOR 10 SEC
 4. PRODUCT SPEC : GS-12-386
 5. PACKING SPEC : GS-14-1109
 6. A SYMBOL Δ WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION
- PACKING: TRAY PACKING
BLANK: TRAY PACKING
1: 15U" GOLD PLATING
2: 2U" G/F GOLD PLATING
3: 15U" GOLD PLATING WITH NEW PINOUT ASSIGNMENT
- 0: LAYOUT?!



PDFfill PDF Editor With Free Writer and Tools



P.C.B. BOARD MOUNTING DIMENSIONS T=1.60mm
PCB TOLERANCE: ±0.05

PIN DEFINITION

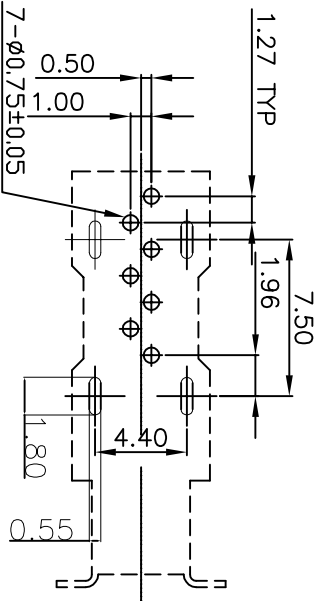
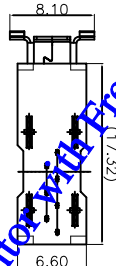
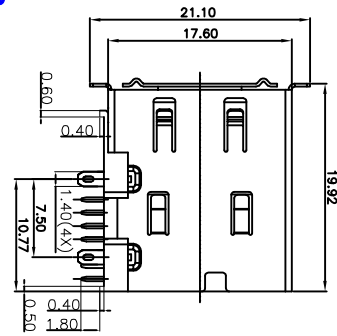
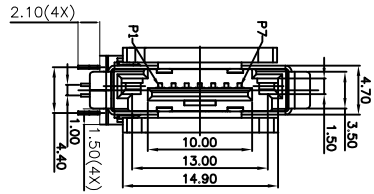
ESATA	NAME	TYPE
P1	GND	A+
P2	A+	A-
P3	A-	GND
P4	GND	B-
P5	B-	B+
P6	B+	GND
P7	GND	

mat'l. code	lfr	ecm no	dr	date	surface	sg	tolerance	projection	product family												
	14				ISO 1302	√	ISO 406 150	100%	533												
	A	107-1074S	LNK	2007-05-23	tolerances unless otherwise specified		.XX±0.38	MM	E-SATA_UP_RIGHT												
	B	108-1082S	LNK	2008-04-28	angle		.XX±0.25		DIP_TYPE												
	C	110-0184S	LNK	2010-12-14	linear		.XXX±0.100	scale 2:1													
	D	T-00544QS	LNK	2011-08-31	STERLING	LNK	2007-05-21														
	E	ex-s-00781	HKL	2011-10-17	eng		HKLIM	2016-03-03													
	F	ex-s-01187	HKL	2012-06-08	ch		HKLIM	2016-03-03													
	G	ex-s-2340	HKL	2016-03-03	qpp		KPTAY	2016-03-03													
Sheet	Revision	G	G	G	107	109	111	113	115	117	119	121	123	125	127	129	131	133	135	137	139
Index	Sheet	1	2	3	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138

- NOTES:
1. MATERIAL: HOUSING: THERMAL PLASTIC HIGH TEMP WITH 30% G/F U94 V-0 COLOR: BLACK CONTACT: COPPER ALLOY SHELL/BOARD LOCK: COPPER ALLOY
 2. CONTACT: GOLD PLATING ON CONTACT AREA 100µ" MIN. WATT TIN PLATING ON SOLDERMILLS 50µ" MIN. NICKEL UNDERPLATING OVER ALL BOARD LOCK: 50µ" MIN. NICKEL PLATING OVER ALL SHELL/BOARD LOCK: 50µ" MIN. WATT TIN PLATING OVER ALL
 3. N/A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.5MM P/B
 4. PRODUCT SPEC : GS-12-398
 5. PACKING SPEC : GS-14-1109
 6. PRODUCT NUMBERING: 10074141 - 0 0 0 LF LEAD FREE
- PAKING: BLANK: TRAY PACKING
1: 1.5µ" GOLD PLATING
2: 0.7µ" GOLD PLATING
6. A SYMBOL Δ WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW OR NOTE, WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION
- 1: LAYOUT/2



dwg no 10074141 sheet 2 of 3 size A3



P.C.B. BOARD MOUNTING DIMENSIONS T=1.60mm
PCB TOLERANCE: ±0.05

PIN DEFINITION	
ESATA	NAME TYPE
	P1 GND
	P2 A+
	P3 A-
	P4 GND
	P5 B-
	P6 B+
	P7 GND

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

mat'l. code	14	surface	ISO 1302	ISO 406	ISO 150	100	projection	product family	533												
lfr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified	angles	linear	XXX±0.100	scale	2:1												
A	107-1074S	LIN	2007-05-23			.X±0.38	MM	E-SATA_UP_RIGHT													
B	108-1082S	LIN	2008-04-28			.XX±0.25		DIP_TYPE													
C	110-0184S	LIN	2010-12-14	0±Z		.XXX±0.100	scale	2:1													
D	T-00544QS	LIN	2011-08-31	dr		STERLING	LIN	2007-05-24													
E	EX-S-0078R	HKL	2011-10-17	engr		HKLIM		2016-03-03													
F	EX-S-0118R	HKL	2012-06-08	chr		HKLIM		2016-03-03													
G	EX-S-234W	HKL	2016-03-03	dpd		KPTAY		2016-03-03													
Sheet	Revision	1	2	3	107	109	111	113	115	117	119	121	123	125	127	129	131	133	135	137	139
Index	Sheet	G	G	G	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138

- NOTES:
1. MATERIAL: THERMOPLASTIC HIGH TEMP WITH 30% G/F UL94 V-0
 2. FINISH: CONTACT: COPPER ALLOY; SHELL/BOARD LOCK: COPPER ALLOY
 3. CONTRACT/GOLD PLATING ON CONTACT AREA
 4. BOARD LOCK: 50μ" MIN. NICKEL UNDERPLATING OVER ALL SHELL/BOARD LOCK; 50μ" MIN. NICKEL PLATING OVER ALL
 5. IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.5MM PCB
 6. PRODUCT SPEC: 05-12-386
 7. PACKING SPEC: 05-14-1109
 8. PRODUCT NUMBERING: 10074141 - 2 0 X X X LF - LEAD FREE
6. A SYMBOL Δ WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW OR NOTE, WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION
- 2: LAYOUTS
1: 15μ" GOLD PLATING
2: 0.7μ" GOLD PLATING
PACKING: TRAY PACKING
BLANK: TRAY PACKING

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9